

# 2021-2027年中国电子材料 行业深度分析与投资可行性报告

## 报告目录及图表目录

智研数据研究中心 编制

[www.abaogao.com](http://www.abaogao.com)

## 一、报告报价

《2021-2027年中国电子材料行业深度分析与投资可行性报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.abaogao.com/b/dianzi/W918947Z8T.html>

报告价格：印刷版：RMB 9800 电子版：RMB 9800 印刷版+电子版：RMB 10000

智研数据研究中心

订购电话：400-600-8596(免长话费) 010-80993963

海外报告销售：010-80993963

传真：010-60343813

Email：sales@abaogao.com

联系人：刘老师 谭老师 陈老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、说明、目录、图表目录

至2016年，国内电子材料占比仍非常低（不超过10%），高端封装材料更是几乎空白，严重阻碍了国内电子产业的发展。

目前，中国大陆先进电子高端封装市场基本由国外厂商和台湾厂商主导，ASE、Amkor、SPIL等占据了绝大部分市场份额，中国大陆供货商只有江阴长电、华天科技、通富微电等少数几家，其市场占有率也少之又少。

封装测试是集成电路制造的后道工序，集成电路封装是把通过测试的晶圆进一步加工得到独立芯片的过程，目的是为芯片的触点加上可与外界电路连接的功能，如加上引脚，使之可以与外部电路如PCB板连接。同时，封装能够为芯片加上一个“保护壳”，防止芯片受到物理或化学损坏。在封装环节结束后的测试环节会针对芯片进行电气功能的确认。

电子材料的发展为我国电子信息制造业实现从无到有、从小到大的重大转变提供了重要的技术支撑，为重大工程建设、国防巩固提供了重要保障。电子产品细分行业利润增速情况

智研数据研究中心发布的《2021-2027年中国电子材料行业深度分析与投资可行性报告》共一章。首先介绍了中国电子材料行业市场发展环境、电子材料整体运行态势等，接着分析了中国电子材料行业市场运行的现状，然后介绍了电子材料市场竞争格局。随后，报告对电子材料做了重点企业经营状况分析，最后分析了中国电子材料行业发展趋势与投资预测。您若对电子材料产业有个系统的了解或者想投资中国电子材料行业，本报告是您不可或缺的重要工具。 本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

### 第一章 电子材料行业相关概述

#### 1.1 电子材料相关概述

##### 1.1.1 电子材料概念

##### 1.1.2 电子材料分类

##### 1.1.3 电子材料特性

#### 1.2 电子材料产业发展特点

##### 1.2.1 寡头垄断特征

##### 1.2.2 上下游关联性强

- 1.2.3 技术品种复杂
- 1.2.4 本土化发展趋势
- 1.3 电子材料细分行业介绍
  - 1.3.1 半导体材料
  - 1.3.2 磁性材料
  - 1.3.3 光电子材料
  - 1.3.4 电子陶瓷

## 第二章 2015-2019年中国电子材料行业发展分析

### 2.1 2015-2019年中国电子材料行业发展现状

- 2.1.1 行业发展规模
- 2.1.2 市场竞争格局
- 2.1.3 行业进出口现状
- 2.1.4 行业发展驱动力分析
- 2.1.5 电子材料重要性分析
- 2.1.6 细分市场投资象限分析

### 2.2 2015-2019年国内行业投资动态分析

- 2.2.1 海外并购投资动态
- 2.2.2 本土显示材料投资
- 2.2.3 南京百亿级台资项目
- 2.2.4 内蒙电子新材料投资
- 2.2.5 湖州半导体材料投资
- 2.2.6 宁夏硅材料投资项目

### 2.3 行业发展问题分析

- 2.3.1 对外依存度高
- 2.3.2 产业层次较低
- 2.3.3 高层次人才匮乏
- 2.3.4 融资压力较大

### 2.4 行业发展建议

- 2.4.1 加强政策力度
- 2.4.2 提高国际化水平
- 2.4.3 加强人才培养

#### 2.4.4 拓宽融资渠道

### 2.5 中国电子材料行业前景展望

#### 2.5.1 电子材料国产化趋势

#### 2.5.2 电子材料低碳趋势

#### 2.5.3 柔性电子材料发展前景

## 第三章 2015-2019年半导体材料行业发展分析

### 3.1 半导体材料行业发展综合分析

#### 3.1.1 半导体材料发展情况

#### 3.1.2 半导体材料实力增强

#### 3.1.3 国内市场规模现状

#### 3.1.4 材料国产化途径分析

#### 3.1.5 有机半导体材料分析

#### 3.1.6 半导体化学品综述

### 3.2 2015-2019年半导体硅片材料市场分析

#### 3.2.1 国际市场垄断局面

#### 3.2.2 大陆产能发展规模

#### 3.2.3 国内行业发展瓶颈

#### 3.2.4 国内项目投资动态

#### 3.2.5 未来市场规模预测

### 3.3 2015-2019年半导体光刻胶市场分析

#### 3.3.1 光刻胶相关概述

#### 3.3.2 全球市场发展规模

#### 3.3.3 中国市场分布格局

#### 3.3.4 IC光刻胶市场竞争分析

#### 3.3.5 半导体光刻胶发展趋势

### 3.4 2015-2019年半导体抛光材料市场分析

#### 3.4.1 CMP抛光材料概述

#### 3.4.2 全球市场发展规模

#### 3.4.3 国际市场竞争格局

#### 3.4.4 国内市场增长迅速

### 3.5 半导体材料行业投资潜力分析

- 3.5.1 国家扶持基金
- 3.5.2 投资空间广阔
- 3.5.3 并购投资机遇
- 3.5.4 投资风险提示
- 3.5.5 投资规模预测

## 第四章 2015-2019年光电子材料所属行业发展分析

### 4.1 光电子材料行业综合分析

- 4.1.1 光电子材料概述
- 4.1.2 光电子晶体材料
- 4.1.3 光导纤维材料
- 4.1.4 OLED材料概述
- 4.1.5 材料发展趋势分析

### 4.2 OLED材料

- 4.2.1 OLED产业链
- 4.2.2 全球市场格局
- 4.2.3 国内供给情况
- 4.2.4 国内竞争格局
- 4.2.5 竞争主体分析

### 4.3 玻璃基板

- 4.3.1 玻璃基板概述
- 4.3.2 产业发展规模
- 4.3.3 外商投资热潮
- 4.3.4 产业突破发展
- 4.3.5 超薄玻璃分析

### 4.4 偏光片

- 4.4.1 偏光片概述
- 4.4.2 偏光片产业链
- 4.4.3 全球市场现状2014-2019年全球偏光片市场需求量走势预测
- 4.4.4 国内市场规模
- 4.4.5 企业投资动态

### 4.5 光导纤维

4.5.1 行业发展分析

4.5.2 市场运营现状

4.5.3 市场发展动态

4.5.4 发展前景向好

4.6 光纤预制棒

4.6.1 光纤预制棒概述

4.6.2 国内产业历程

4.6.3 行业发展现状

4.6.4 项目投资动态

## 第五章 2015-2019年磁性材料所属行业发展分析

5.1 磁性材料行业综合分析

5.1.1 磁性材料产业链

5.1.2 行业五力模型分析

5.1.3 行业主要壁垒分析

5.1.4 软磁材料市场发展

5.2 钕铁硼永磁新材料分类概述

5.2.1 粘结钕铁硼材料

5.2.2 烧结钕铁硼材料

5.2.3 热压钕铁硼材料

5.2.4 三类钕铁硼对比分析

5.3 2015-2019年钕铁硼永磁材料下游市场需求分析

5.3.1 音圈电机

5.3.2 智能手机

5.3.3 变频空调

5.3.4 节能电梯

5.3.5 传统汽车

5.4 2015-2019年国内磁性材料行业竞争主体分析

5.4.1 中科三环

5.4.2 正海磁材

5.4.3 银河磁体

5.4.4 宁波韵升

#### 5.4.5 安泰科技

### 第六章 2015-2019年电子陶瓷材料所属行业发展分析

#### 6.1 2015-2019年电子陶瓷行业综合分析

##### 6.1.1 电子陶瓷产业链

##### 6.1.2 波特五力模型分析

##### 6.1.3 全球市场发展规模

##### 6.1.4 主要原材料市场格局

##### 6.1.5 行业发展机遇与挑战

#### 6.2 2015-2019年氧化锆陶瓷材料行业发展情况

##### 6.2.1 氧化锆陶瓷优势分析

##### 6.2.2 国外龙头企业发展借鉴

##### 6.2.3 行业下游市场应用分析

##### 6.2.4 氧化锆陶瓷后盖市场预测

##### 6.2.5 氧化锆贴片市场前景预测

#### 6.3 电子陶瓷其他细分领域发展情况分析

##### 6.3.1 高压陶瓷

##### 6.3.2 光纤陶瓷插芯

##### 6.3.3 燃料电池隔膜板

##### 6.3.4 SMD封装基座

##### 6.3.5 氧化铝陶瓷基片

##### 6.3.6 MLCC电容器

##### 6.3.7 微波介质陶瓷

#### 6.4 2015-2019年电子陶瓷材料行业竞争主体分析

##### 6.4.1 三环集团

##### 6.4.2 顺络电子

##### 6.4.3 国瓷材料

##### 6.4.4 蓝思科技

### 第七章 2015-2019年其它电子材料发展分析

#### 7.1 电子封装材料

##### 7.1.1 电子封装材料概述



- 7.1.2 封装材料性能要求
- 7.1.3 传统电子封装材料
- 7.1.4 金属基复合封装材料
- 7.1.5 环氧树脂封装材料
- 7.1.6 电子封装材料发展趋势
- 7.2 覆铜板
  - 7.2.1 PCB材料市场背景
  - 7.2.2 全球覆铜板市场现状
  - 7.2.3 国内行业供给需分析
  - 7.2.4 中国外贸市场发展情况
  - 7.2.5 “十三五”行业前景展望
- 7.3 超净高纯试剂
  - 7.3.1 超净高纯试剂概述
  - 7.3.2 全球市场分布格局
  - 7.3.3 国内行业产能分析
  - 7.3.4 国内市场竞争情况
  - 7.3.5 国内行业发展预测
- 7.4 电子气体
  - 7.4.1 电子气体概述
  - 7.4.2 全球市场规模
  - 7.4.3 国内市场格局
  - 7.4.4 行业前景向好

## 第八章 中国电子材料产业投资分析

- 8.1 投资动态
  - 8.1.1 本土显示材料投资
  - 8.1.2 南京百亿级台资项目
  - 8.1.3 内蒙电子新材料投资
  - 8.1.4 湖州半导体材料投资
  - 8.1.5 宁夏硅材料投资项目
- 8.2 投资机会
  - 8.2.1 超薄玻璃

8.2.2 柔性材料

8.2.3 光学膜材料

8.2.4 半导体纳米晶体(量子点)

8.3 投资风险

8.3.1 新产品开发风险

8.3.2 人员流动风险

8.3.3 项目决策失误风险

8.3.4 企业资金链保障的风险

详细请访问：<http://www.abaogao.com/b/dianzi/W918947Z8T.html>